

# 2013-2017年中国印制电路板(PCB)市场分析与投资前景研究报告

## 报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

[www.bosidata.com](http://www.bosidata.com)

# 报告报价

《2013-2017年中国印制电路板(PCB)市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1303/501285AXDH.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2013-03-06

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

# 说明、目录、图表目录

## 报告说明:

博思数据发布的《2013-2017年中国印制电路板(PCB)市场分析与投资前景研究报告》共九章。首先介绍了PCB的定义、分类及产业链等，接着分析了国内外PCB产业发展现状，并对印制电路板制造业的财务状况进行了细致透析。随后，报告对PCB制造技术、原材料市场、应用领域及国内外PCB重点企业的运营状况做了分析。最后，对PCB未来发展前景做出了科学的预测。

通过《2013-2017年中国印制电路板(PCB)市场分析与投资前景研究报告》，生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业发展提供了科学决策依据。

PCB ( Printed Circuit Board )，中文名称为印制电路板，又称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接提供者。根据电路层数可分为单面板、双面板和多层板。常见的多层板一般为4层板或6层板，复杂的多层板可达十几层。

在中国成为电子产品制造大国的同时，全球 PCB产能也在向中国转移，不仅内资PCB制造企业加速扩大产能，外资企业也同时加速向中国转移、新增产能，国内PCB行业投资始终火热。产业转移成就中国PCB产业大国，最重要的动力来源于成本和应用产业链两方面。在成本优势方面，中国在劳动力、土地、水电、资源和政策等方面具有巨大的优势；下游产业在中国的蓬勃发展，全球整机制造转移中国，提供了巨大的市场需求空间。中国由于下游产业的集中及劳动力、土地成本相对较低，成为发展势头最为强劲的区域。

从2006年开始，中国就超过日本成为全球第一大PCB制造基地，中国是全球PCB产值最大、增长最快的地区，并已成为推动全球PCB行业发展的主要增长动力。2010年中国大陆PCB产值达到185亿美元，占全球PCB总产值的36.3%。2006年-2010年，中国PCB产值的年均复合增长率达到9.6%，远高于全球2.5%的水平。进入2011年，中国PCB产业继续保持蓬勃发展态势，全年产值达220亿美元，占全球产值的四成。2012年以来，随着市场更多厂商推出Ultrabook、平板计算机和智能型手机产品，拉升国内PCB产业，2012年第2季PCB产值上升2.3%。

中国印制电路板业在内销增长和全球产能持续转移的形势下，将步入高速成长期。中国印制电路板的产业规模占全球比重到2014年将提高到41.92%。我国各类电子产品和LED等的兴起都对印制电路板行业产生强大的推动作用，未来五年中国印制电路板行业仍将保持快速

增长。

## 第一章 PCB的介绍

### 第一节 PCB的介绍

#### 一、PCB的定义

#### 二、PCB的分类

#### 三、PCB的历史

### 第二节 PCB的产业链

#### 一、PCB产业链的构成

#### 二、产业链中的产品介绍

## 第二章 国际PCB产业发展分析

### 第一节 全球PCB产业发展概况

#### 一、国际重点PCB制造企业发展概述

#### 二、2011年全球PCB工业发展分析

#### 三、2012年全球PCB行业发展分析

#### 四、2012年全球PCB产业的格局变化

#### 五、2012年国际柔性电路板行业的发展

#### 六、国外印制电路板制造技术的发展

#### 七、2012年全球PCB行业发展分析及预测

### 第二节 美国

#### 一、美国PCB产业的发展概况

#### 二、美国PCB主要生产厂家的发展

#### 三、2012年北美印刷电路板发展现状

### 第三节 欧洲

#### 一、欧洲PCB产业发展概况

#### 二、2012年德国PCB产业的发展

#### 三、2012年欧洲PCB行业发展分析

### 第四节 日本

#### 一、日本PCB产业的发展阶段

#### 二、日本PCB产业的发展回顾

#### 三、2012年日本PCB产业的发展

#### 四、日本领先PCB厂商发展高端路线

## 第五节 台湾地区

- 一、2011年台湾PCB产业的发展
- 二、2012年台湾PCB产业的发展
- 三、台湾PCB企业在大陆市场的发展动态

## 第三章 中国PCB产业发展分析

### 第一节 我国PCB产业的发展概况

- 一、我国PCB产业的产值及产能
- 二、我国PCB产业的产品结构
- 三、我国PCB行业配套日渐完善
- 四、2012年我国PCB行业的发展
- 五、2012年我国PCB产业的发展机遇

### 第二节 PCB产业竞争力分析

- 一、竞争对手
- 二、替代品
- 三、潜在进入者
- 四、供应商的力量

### 第三节 HDI市场发展分析

- 一、HDI市场容量
- 二、HDI市场供求
- 三、HDI市场趋势

### 第四节 我国PCB产业发展问题及对策

- 一、我国PCB产业与国外存在的差距
- 二、PCB产业发展面临的挑战
- 三、PCB产业持续发展的措施
- 四、PCB产业需发展民族品牌

## 第四章 PCB制造技术的研究

### 第一节 PCB芯片封装焊接方法及工艺流程的阐述

- 一、PCB芯片封装的介绍
- 二、PCB芯片封装的主要焊接方法
- 三、PCB芯片封装的流程

## 第二节 光电PCB技术

- 一、光电PCB的概述
- 二、光电PCB的光互连结构原理
- 三、光学PCB的优点
- 四、光电PCB的发展阶段

## 第三节 PCB技术的发展趋势

- 一、向高密度互连技术方向发展
- 二、组件埋嵌技术的发展
- 三、材料开发的提升
- 四、光电PCB的前景广阔
- 五、先进设备的引入

## 第五章 PCB上游原材料市场分析

### 第一节 铜箔

- 一、铜箔的相关概述
- 二、铜箔在柔性印制电路中的应用
- 三、电解铜箔产业的发展概况

### 第二节 环氧树脂

- 一、环氧树脂的相关概述
- 二、环氧树脂的主要应用领域
- 三、我国环氧树脂产业的发展现状

### 第三节 玻璃纤维

- 一、玻璃纤维的相关概述
- 二、我国成为全球最大玻璃纤维生产国
- 三、2012年我国玻璃纤维行业经济运行情况
- 四、2012年玻璃纤维产业的发展情况

## 第六章 PCB下游应用领域分析

### 第一节 消费类电子产品

- 一、2012年我国消费电子产品走向高端
- 二、消费电子用PCB市场需求稳定增长
- 三、高端电子消费品市场需求带动HDI电路板趋热

## 第二节 通讯设备

一、2012年我国通讯设备制造业发展情况

二、2012年我国通信设备业的发展

三、语音通讯移动终端用PCB的发展趋势

## 第三节 汽车电子

一、PCB成为汽车电子市场的热点

二、多优点PCB式汽车继电器市场不断壮大

三、2012年全球汽车电子PCB市场发展预测

## 第四节 LED照明

一、2012年中国LED照明的发展状况

二、LED发展为PCB行业带来新需求

## 第七章 国外重点PCB制造商介绍

### 第一节 日本企业

一、日本揖斐电株式会社(IBIDEN)

二、日本旗胜 ( Nippon Mektron )

三、日本CMK公司

### 第二节 美国企业

一、MULTEK

二、美国TTM

三、新美亚 ( SANMINA-SCI )

四、惠亚集团 ( Viasystems )

### 第三节 韩国企业

一、三星电机 ( Samsung E-M )

二、永丰 ( Young Poong Group )

三、LG Electronics

### 第四节 台湾企业

一、欣兴电子

二、健鼎科技

三、雅新电子

## 第八章 国内PCB上市公司介绍

## 第一节 沪电股份

### 一、公司简介

### 二、2011年沪电股份经营状况分析

### 三、2012年沪电股份经营状况分析

## 第二节 天津普林

### 一、公司简介

### 二、2011年天津普林经营状况分析

### 三、2012年天津普林经营状况分析

## 第三节 生益科技

### 一、公司简介

### 二、2011年生益科技经营状况分析

### 三、2012年生益科技经营状况分析

## 第四节 超声电子

### 一、公司简介

### 二、2011年超声电子经营状况分析

### 三、2012年超声电子经营状况分析

## 第五节 超华科技

### 一、公司简介

### 二、2011年超华科技经营状况分析

### 三、2012年超华科技经营状况分析

## 第九章 2013-2017年PCB行业投资分析及前景预测

### 第一节 2013-2017年PCB投资分析

#### 一、PCB行业SWOT分析

#### 二、PCB投资面临的风险

#### 三、PCB市场投资空间大

### 第二节 2013-2017年PCB产业发展前景预测

#### 一、2013年PCB产业的发展前景

#### 二、2013年软板与HDI板发展前景向好

#### 三、2013-2017年我国印制电路板产业的发展前景预测

#### 四、未来我国PCB行业将保持高速增长

#### 五、十二五期间我国PCB产业的发展重点



图表目录：

图表：各国家地区PCB工厂数目

图表：2011年全球不同种类PCB的增长率（按产品类型分）

图表：2011年电子整机及PCB的应用领域和未来发展

图表：2011年全球各国PCB产值

图表：2011年电子工业（半导体）和PCB工业的增长

图表：2012年全球各地区PCB产值分布

图表：2012年全球主要手机PCB板厂家市场占有率

图表：2000年和2012年全球PCB下游应用比例

图表：2000年和2012年全球PCB产品结构

图表：美国PCB产值变化情况

图表：日本PCB产量统计表

图表：日本PCB厂家海外产值（按产品类型分类）

图表：日本PCB厂家海外产值（按国家分类）

图表：日本PCB进出口量（按国别统计）

图表：日本PCB出口量（按地区统计）

图表：2010-2012年日本印刷电路板设备投资额

图表：2011年台湾PCB的资本构成

图表：2011年台湾不同种类PCB的比例

图表：台湾PCB市场规模

图表：2012年中国PCB产业主要本土企业销售收入增长幅度

图表：光学PCB和传统PCB的优点对比

图表：压延退火方法制造的铜箔产品

图表：铜箔的分类

图表：电解铜箔制造过程示意图

图表：铜箔的处理阶段和稳定性

图表：环氧树脂胶粘剂的主要用途

图表：2011-2012年华东环氧树脂市场走势图

图表：2007-2012年华东环氧树脂市场走势图

图表：2012年全国玻璃纤维纱累计产量

图表：2012年玻纤及制品主要进口来源地

图表：2011年7月-2012年9月玻璃纤维及制品当月出口量

图表：2012年通信设备制造业工业销售情况

图表：2012年我国通信设备产品产量及增长

图表：2012年我国通讯设备主要出口产品增长情况

图表：2012年我国通讯设备主要进口产品增长情况

图表：2012年通信设备制造业、计算机及其他电子设备制造业投资情况

图表：2012年通信设备制造业不同所有制企业经营情况

图表：2012年通信设备制造业不同规模企业经营情况

图表：全球手机销售量与Smart Phone市场渗透率

图表：2012年国内LED产量、芯片产量及芯片国产率

图表：2003-2012年我国LED市场规模及增长率变化

图表：2003-2012年我国LED封装产量变化

图表：2012年我国半导体照明应用领域

图表：2012年9月国内外功率型白光LED技术指标对比

图表：2012年沪电股份主营构成表

图表：2010-2012年沪电股份流动资产表

图表：2010-2012年沪电股份长期投资表

图表：2010-2012年沪电股份固定资产表

图表：2010-2012年沪电股份无形及其他资产表

图表：2010-2012年沪电股份流动负债表

图表：2010-2012年沪电股份长期负债表

图表：2010-2012年沪电股份股东权益表

图表：2010-2012年沪电股份主营业务收入表

图表：2010-2012年沪电股份主营业务利润表

图表：2010-2012年沪电股份营业利润表

图表：2010-2012年沪电股份利润总额表

图表：2010-2012年沪电股份净利润表

图表：2010-2012年沪电股份每股指标表

图表：2010-2012年沪电股份获利能力表

图表：2010-2012年沪电股份经营能力表

图表：2010-2012年沪电股份偿债能力表

图表：2010-2012年沪电股份资本结构表

图表：2010-2012年沪电股份发展能力表

图表：2010-2012年沪电股份现金流量分析表

图表：2012年沪电股份非经常性损益项目及金额

图表：2012年天津普林主营构成表

图表：2010-2012年天津普林流动资产表

图表：2010-2012年天津普林长期投资表

图表：2010-2012年天津普林固定资产表

图表：2010-2012年天津普林无形及其他资产表

图表：2010-2012年天津普林流动负债表

图表：2010-2012年天津普林长期负债表

图表：2010-2012年天津普林股东权益表

图表：2010-2012年天津普林主营业务收入表

图表：2010-2012年天津普林主营业务利润表

图表：2010-2012年天津普林营业利润表

图表：2010-2012年天津普林利润总额表

图表：2010-2012年天津普林净利润表

图表：2010-2012年天津普林每股指标表

图表：2010-2012年天津普林获利能力表

图表：2010-2012年天津普林经营能力表

图表：2010-2012年天津普林偿债能力表

图表：2010-2012年天津普林资本结构表

图表：2010-2012年天津普林发展能力表

图表：2010-2012年天津普林现金流量分析表

图表：2012年生益科技主营构成表

图表：2010-2012年生益科技流动资产表

图表：2010-2012年生益科技长期投资表

图表：2010-2012年生益科技固定资产表

图表：2010-2012年生益科技无形及其他资产表

图表：2010-2012年生益科技流动负债表

图表：2010-2012年生益科技长期负债表

图表：2010-2012年生益科技股东权益表

图表：2010-2012年生益科技主营业务收入表

图表：2010-2012年生益科技主营业务利润表

图表：2010-2012年生益科技营业利润表

图表：2010-2012年生益科技利润总额表

图表：2010-2012年生益科技净利润表

图表：2010-2012年生益科技每股指标表

图表：2010-2012年生益科技获利能力表

图表：2010-2012年生益科技经营能力表

图表：2010-2012年生益科技偿债能力表

图表：2010-2012年生益科技资本结构表

图表：2010-2012年生益科技发展能力表

图表：2010-2012年生益科技现金流量分析表

图表：2012年超声电子主营构成表

图表：2010-2012年超声电子流动资产表

图表：2010-2012年超声电子长期投资表

图表：2010-2012年超声电子固定资产表

图表：2010-2012年超声电子无形及其他资产表

图表：2010-2012年超声电子流动负债表

图表：2010-2012年超声电子长期负债表

图表：2010-2012年超声电子股东权益表

图表：2010-2012年超声电子主营业务收入表

图表：2010-2012年超声电子主营业务利润表

图表：2010-2012年超声电子营业利润表

图表：2010-2012年超声电子利润总额表

图表：2010-2012年超声电子净利润表

图表：2010-2012年超声电子每股指标表

图表：2010-2012年超声电子获利能力表

图表：2010-2012年超声电子经营能力表

图表：2010-2012年超声电子偿债能力表

图表：2010-2012年超声电子资本结构表

图表：2010-2012年超声电子发展能力表

图表：2010-2012年超声电子现金流量分析表

图表：2012年超华科技主营构成表

图表：2010-2012年超华科技流动资产表

图表：2010-2012年超华科技长期投资表

图表：2010-2012年超华科技固定资产表

图表：2010-2012年超华科技无形及其他资产表

图表：2010-2012年超华科技流动负债表

图表：2010-2012年超华科技长期负债表

图表：2010-2012年超华科技股东权益表

图表：2010-2012年超华科技主营业务收入表

图表：2010-2012年超华科技主营业务利润表

图表：2010-2012年超华科技营业利润表

图表：2010-2012年超华科技利润总额表

图表：2010-2012年超华科技净利润表

图表：2010-2012年超华科技每股指标表

图表：2010-2012年超华科技获利能力表

图表：2010-2012年超华科技经营能力表

图表：2010-2012年超华科技偿债能力表

图表：2010-2012年超华科技资本结构表

图表：2010-2012年超华科技发展能力表

图表：2010-2012年超华科技现金流量分析表

本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、博思数据库、中国印制电路行业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对PCB产业有个系统的了解、或者想投资PCB产业，本报告是您不可或缺的重要工具。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1303/501285AXDH.html>